

化学工学会 粒子・流体プロセス部会

気泡・液滴・微粒子分散工学分科会 第30回気液固分散工学サロン

日時と場所：2025年3月12日（化学工学会第90回年会1日目）

東京理科大学 葛飾キャンパス G会場を予定しています

17時～17時30分 2024年度第2回総会

17時30分～18時30分 第30回気液固分散工学サロン

19時～ 懇親会

サロン講師：金井 由悟 先生（福岡大学）

講演タイトル「水平円筒槽内で気泡流によって誘起される液面振動現象」

会費：無料でご聴講頂けます。別途、懇親会費(4000円、学生半額を予定)を当日ご集金させていただきます。

下記 URL よりお申し込みをお待ちしております。

化学工学会の年会登録と合わせてご計画ください。

参加申し込み URL：<https://forms.gle/xuoN8mqGBhbwECxPA>

一次締切: 3月5日(水)

例年より早いお知らせですが、懇親会会場の早期確保のため、ご協力をよろしくお願ひします。

お問い合わせ：島田 shimadan@sc.sumitomo-chem.co.jp まで